

株主メモ

事業年度	毎年4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会	毎年6月開催
基準日	期末配当金 毎年3月31日 中間配当金 毎年9月30日 そのほか必要があるときは、あらかじめ公告して定めた日
単元株式数	100株
株主名簿管理人および 特別口座の口座管理機関	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
株主名簿管理人 同事務取扱場所 (郵便物送付先)	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 〒168-0063東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
(電話照会先)	☎0120-782-031
(インターネットホームページURL)	https://www.smtb.jp/personal/agency/index.html
公告の方法	当社のホームページに掲載する https://www.ferrotec.co.jp/
上場証券取引所	株式会社東京証券取引所 JASDAQスタンダード

・株主に関する住所変更等のお届出およびご照会について

証券会社の口座をご利用の場合は、三井住友信託銀行ではお手続きができませんので、取引証券会社へご照会ください。証券会社の口座のご利用がない株主様は、上記電話照会先までご連絡ください。

年間IRカレンダー

第2四半期			第3四半期			第4四半期			第1四半期		
7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
第1四半期開示	第2四半期決算		第2四半期決算発表 第2四半期決算説明会			第3四半期開示	本決算		決算発表 決算説明会	株主総会	

Ferro Tec

株式会社 フェローテックホールディングス

〒103-0027

東京都中央区日本橋2-3-4 日本橋プラザビル5階

TEL 03-3281-8808 FAX 03-3281-8848

URL <https://www.ferrotec.co.jp/>

UD FONT

見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。



森林に配慮して適切に管理された森林認証紙を使用しています。



環境に配慮した植物油インキを使用しています。

第41期 決算報告

2020年4月1日～2021年3月31日

証券コード：6890



Ferro Tec

株式会社 フェローテックホールディングス

株主の皆さまへ



代表取締役社長
グループCEO
賀 賢漢

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

新型コロナウイルス感染症により、影響を受けられました皆さまにお見舞い申し上げます。ここに第41期決算報告をお届けするにあたりご挨拶申し上げます。

当社グループは、つがなく創立40周年を迎えることが出来ました。

ひとえに株主の皆さまのご支援、ご鞭撻の賜物であると心から感謝申し上げます。

米中貿易摩擦の長期化や新型コロナウイルス感染症の影響もあり、年初は半導体メーカーの設備投資意欲は弱含みで推移しましたが、年央から回復に転じ、前年を上回る需要となりました。特に中国半導体市場の需要は旺盛なものでした。

当社グループでは、お客様からの需要にお応えするために品質を第一に考えて顧客満足の向上を追求する旨の「品質理念」を掲げ、生産の自動化、デジタル化、標準化を進めております。

また、国内子会社3社を経営統合し、中国子会社の上場を目指すため組織再編を行い、製品強化のためM&Aを実施するなど積極的に施策を実行いたしました。

特にシリコンウエーハを取扱う中国子会社の株式を中国地方政府系ファンドおよび投資基金等へ譲渡、第三者割当を行うなど、資金調達が多様化を進め当社グループの財務体質は安定的なものとなりました。

当社グループの経営の基本方針に基づき、株主の皆さまにとって「成長する楽しみが持てる企業」であり続けることに努めてまいります。

株主の皆さまにおかれましては、今後とも格別のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

2021年7月吉日

財務ハイライト

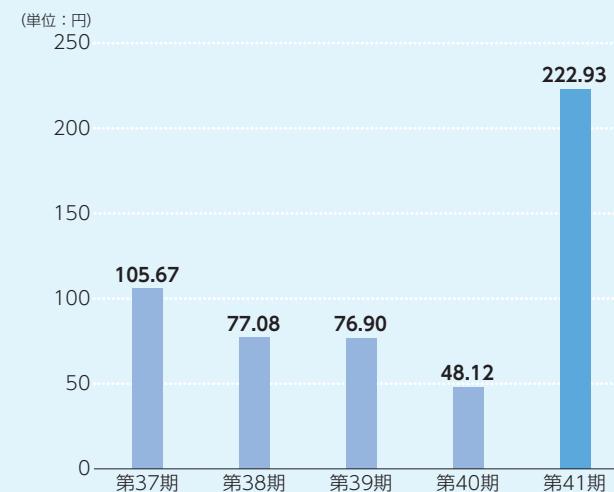
売上高／経常利益



総資産／純資産



1株当たり当期純利益



ROE(自己資本当期純利益率)／ROA(総資産経常利益率)





事業成長・利益成長 を徹底的に追求、成長投資を継続

成長期待の高い半導体分野、電子デバイス分野での増産投資を進め、当社ポジションを引上げ。また将来の成長に向け、EV(電気自動車)関連等への投資も推進。

親会社株主に帰属する
当期純利益

150億円

売上高当期純利益率
10.0%

事業成長

売上高
1,500億円

今後3ヶ年の事業計画の前提となる
市場環境の認識

- 地域別半導体市場予測：
2020年は5.1%増、2021年は8.4%増と堅調な見通し。
- 半導体製造装置市場：
WFE(半導体前工程装置)市場は2019年に落ち込むも2020年以降は当面、前年比成長を予測。
- 中国市場：
2020年の中国の半導体製造装置販売額は187.2億米ドルで世界最大。前年比で+39%と伸び率も著しく、世界一の半導体市場へと成長(需要拡大が顕著)。

ROE
15%

品質強化

『品質は命』と考え、 品質管理の強化を進める

品質管理、自動化・デジタル化による生産体制強化を推進。

自己資本比率
40%超

人材強化

人材の強化、組織の構造 改革を推進

企業規模が拡大するなか、更に持続的な成長を実現するため、人材の採用・育成、組織態勢の改革、企業文化の醸成を推進。

財務強化を更に推進、投資機会と 財務状況の適切なバランスを確保

親会社株主に帰属する当期純利益をKPI化、投資リターン・ROIC管理を強化、外部資本活用を適切に検討。

営業利益
250億円
売上高営業利益率
16.7%

ROIC
8%

主な取り組みポイント① 中長期的成長の主力となる事業に注力



- 半導体マテリアルは、中でも特に石英製品が順調に売上を伸ばしていく見通し。
- サーモモジュールは、RMT子会社化で、通信分野などの高付加価値モジュール技術を取り込む。
- 部品洗浄は、安徽省銅陵の政府系ファンドも出資先に加わり、今後事業拡大のプロジェクトを目指す。
- パワー半導体基板は、家電・産業機器向けDCB基板、および自動車向けなどのAMB基板を増産対応中。
- 再生ウエーハは、2021年2Qに試作開始、同4Qに量産開始予定。

主な取り組みポイント② 事業成長・利益成長実現へ成長投資を継続



- 営業キャッシュ・フロー総額650億円。親会社株主に帰属する当期純利益をKPI化、利益増加による積み上げ。投資水準を管理、投資リターン・ROIC管理を強化。
- 中国市場における戦略的・長期的な投資、新規事業に中国資本導入を検討(再生ウエーハ事業等)。
- 洗浄、パワー基板、シリコンパーツ・石英坩堝はIPO、新株発行増資を目指す。

連結売上高・営業利益・親会社株主に帰属する当期純利益の推移計画



中国国内でIPOを準備中

中国半導体企業主要拠点の近くに生産拠点を配置し、顧客の満足度向上に取り組むことで、国産化を前提とした市場成長に貢献し、同時に事業拡大を図っています。
そのために、中国外部資本を活用するとともに、成長資金については中国株式市場における資本調達を推進します。



半導体分野における
国家プロジェクトへの参画

中国製造2025

2015年5月に中国政府が発表した国家プロジェクトで、2049年を最終年とする国内製造業強化策の1stステージにあたります。中国の製造業は、課題だったイノベーション能力の不足を克服することで、量の優位から質の優位への転換を目指すものです。



中国子会社グループの再編、および成長資金調達の検討

2020年見通し
半導体の国産化
装置:30%
材料:50%

更なる国産化へ向けて
中国政府による
積極的な優遇政策が
加速する見通し

石英坩堝シリコンパーツ(寧夏富楽徳石英材料有限公司)

- 事業内容：半導体製造用治具・消耗部材の製造、販売
- 第三者割当増資を実施し、製造設備への投資を予定
- 科創板市場への上場を目指す



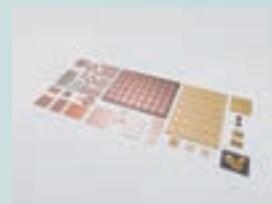
半導体ウエーハ(杭州中欣晶圆半导体股份有限公司)

- 事業内容：半導体ウエーハの製造、販売
- 株式の一部を、中国の政府系・民間系ファンドへ譲渡し、資金調達の多様化を図る
- 中国株式市場への上場を目指す



パワー半導体用基板(江蘇富楽徳半導体科技有限公司)

- 事業内容：パワー半導体用基板の製造、販売
- 第三者割当増資を実施し、設備増強投資、自動化投資、新素材開発投資等製造設備への投資を予定
- 科創板市場への上場を目指す

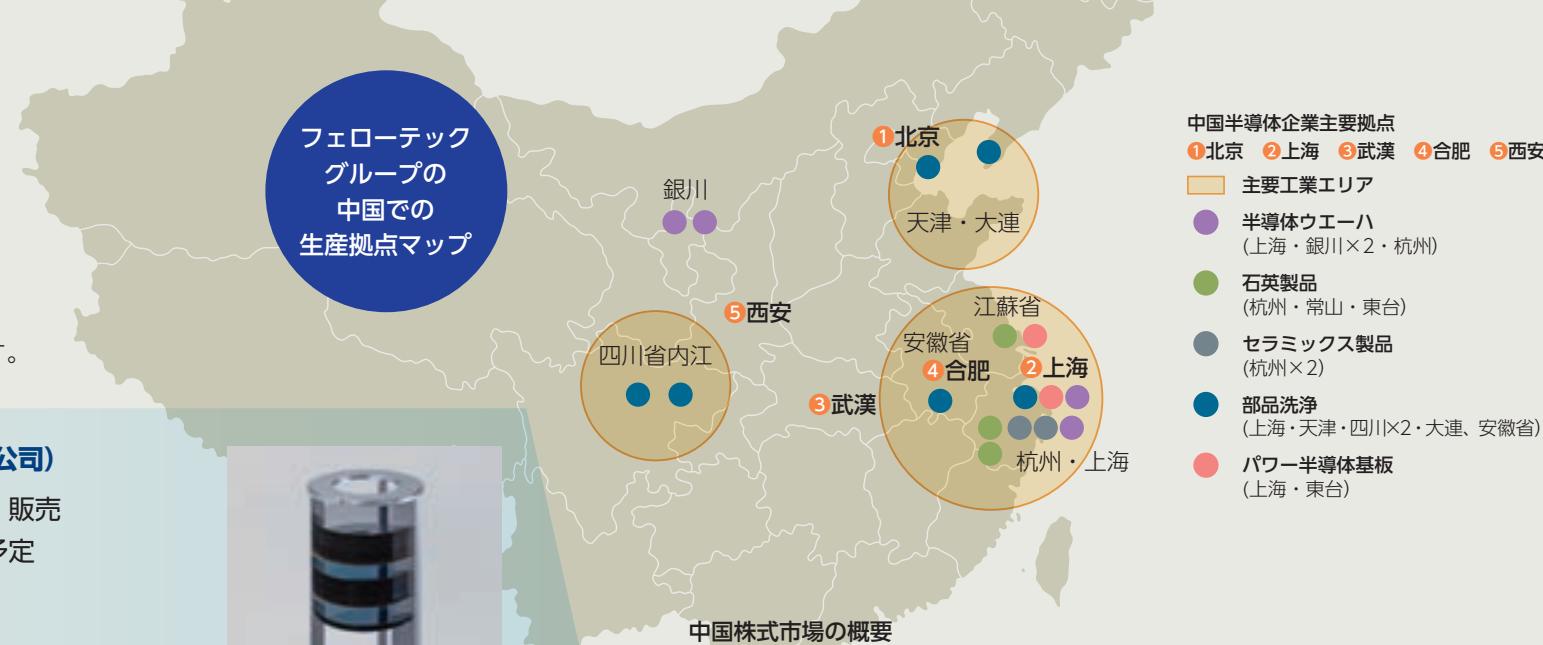


精密部品再生洗浄(安徽富楽徳科技發展股份有限公司)

- 事業内容：半導体・FPD向け高純度プロセスツールパーツ洗浄サービス
- 創業板市場への上場準備中



フェローテック
グループの
中国での
生産拠点マップ



中国株式市場の概要

市場	市場	上場企業数	時価総額
香港市場	メインボード	2,143	41兆3,270億香港ドル
	GEM	375	1,080億香港ドル
上海市場	A株 メインボード	1,374	35兆5,477億人民元
	科創板	183	2兆8,753億人民元
B株	メインボード	49	750億人民元
	深圳市場	メインボード	460
A株	中小板	976	12兆6,747億人民元
	創業板	865	9兆4,786億人民元
B株	メインボード	45	479億人民元

出所: 香港取引所、深圳取引所、データより作成
※上記は、2020年9月30日現在

SiC (炭化ケイ素) 事業への参入

中国科学院、政府・民間系ファンドと 合併会社を設立

2020年10月安徽省銅陵市に、中国科学院上海硅酸盐研究所(SICCAS)、
政府・民間系ファンドとの合併会社を設立しました。

中国での最先端半導体(第3世代半導体)として、今後の市場成長が期待される
SiC(炭化ケイ素)単結晶のインゴット、ウエーハの開発、製造に取り組みます。



SiC単結晶の技術的な課題など

- 結晶育成(大口径化)、基板化加工、電気特性制御、結晶欠陥制御などの技術的難易度が高い。
- このため、欧米、日本の一部企業のみが量産化を実現しているような状況。
- 中国では、電気自動車などの自国需要が増大する中で、国産化を実現したい戦略技術。

課題を解決して量産化を実現

<合併会社で当該事業に取り組む背景>

- 当社グループ**: 半導体Si単結晶事業で培った欠陥制御技術、装置製造技術。CVD-SiC(半導体製造装置向け治具)事業を通じたSiCに対する知見と顧客基盤を保有。
- SICCAS**: 中国トップクラスのSiC研究機関。知財、人材を保有。
- 資金調達**: 政府・民間系ファンド、および政府補助金サポート。

第3世代半導体とは

- 炭化ケイ素(SiC)、窒化ガリウム(GaN)、酸化亜鉛(ZnO)、グラファイト(C)などの新材料を使った半導体を指す。第1世代半導体(シリコンなど)、第2世代半導体(ガリウム砒素など)と比べ、高い電圧、周波数、温度で作動させることができる。
- 5G(第5世代移動通信システム)で使われるRF(無線周波)部品や、高効率の二極管、LED(発光ダイオード)などに使われる半導体として期待される。将来的には、新エネルギー自動車、白物家電、鉄道交通、医療設備などでの活用が想定される。



大泉製作所との 資本提携により 車載関連を強化

株式会社大泉製作所と 資本業務提携契約を締結

当社と中国のNEV企業とのリレーションをはじめとしたグローバルネットワークの活用により、大泉製作所の高品質製品の販売強化につながることに加えて、当社の自動化や生産管理システム導入の経験やノウハウといった経営資源を効果的に活用し、中長期的に両社の企業価値向上を目指します。



中長期的にわたる両社の企業価値の向上へ



ステークホルダーコミュニケーション活動のご紹介

【学生投資連合USIC主催第5回IRプレゼンコンテスト】にて 当社を紹介した「國學院大學投資研究会KISHU」が優勝！

投資リテラシー向上を目指す全国の学生投資サークルで構成する「学生投資連合USIC」主催による「第5回IRプレゼンコンテスト」(2021年2月)にて、当社の財務・ビジネスモデルを分析・発表した國學院大學投資研究会KISHUが優勝されました。

プレゼン資料の制作過程では、チャット形式のコミュニケーションツールを用いたリアルタイムのやりとりも導入し、当社からは多様な情報を提供。当社としては、「プレゼンの仕上がりが素晴らしく、KISHUのプレゼンで当社を知ってくれる人もいだろう。嬉しいの一言」(山村副社長)という思いと共に、KISHUがプレゼンされた通り、フェローテックグループ全体の課題として、サステナブルへの取り組み強化の重要性をあらためて認識することができた貴重な機会ともなりました。



KISHUのメンバーの皆様(左から、清水稜真様、新井湧人様、平山智也様、森永泰成様、近藤裕大様)



コンテストを振り返り盛り上がるKISHUの皆様と山村副社長、営業本部・山本(國學院大學出身)



当社からはコンテスト優勝の記念品を授与させて頂きました(左:山村副社長、右:KISHU・平山様)



©國學院大學投資研究会KISHU



KISHU作成のフェローテックを分析した
プレゼン資料はこちらから
<https://www.ferrotec.co.jp/php/download.php?f=jp/602b43fa0eadd.pdf>



地域別売上高構成比

※()は前期の数字



欧米 **36%**(32%)

フェローテックヨーロッパ(ドイツ)



アジア **50%**(50%)

フェローテックシンガポール



日本 **14%**(18%)

フェローテック本社



各エリア別の ポテンシャル



欧米エリア

- 第41期は前年比6.0%の増収。コロナ禍による「巣籠り需要」「デジタル化進展」や5G、データセンタ受け需要増から半導体製造装置向けマテリアル製品(石英、セラミックス等)が順調に推移(第42期以降も当面堅調に推移の見通し)
- 欧米向け医療・バイオ分野におけるサーモモジュール、磁性流体の安定した需要見通し
- コロナ禍で前期需要減なるも、自動車向け各種製品需要は徐々に回復の見通し



アジアエリア

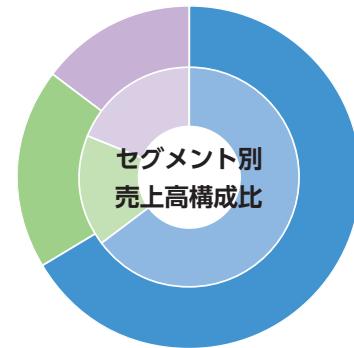
- 第41期は前年比13.4%の増収。世界的なデジタル需要の伸長に伴い、半導体生産拠点が集中する中国・韓国・台湾顧客向けのマテリアル製品、真空シールなどが好調に推移(第42期も新規設備投資、消耗品のリピート需要などが伸長の見通し)
- 中国国内の半導体工場、および有機ELなどパネル工場の生産能力増強に伴い、装置部品洗浄の需要拡大が継続中
- 中国を中心に、5G通信基地局、およびPCR検査用途などのサーモモジュール製品が好調維持の見通し。同様に、脱炭素社会の流れを受け、パワー半導体基板の需要増に期待



日本国内

- 第41期は前年比12.5%の減収。コロナ禍で、上期を中心に自動車向けや産業機器向け製品の需要減の影響有り(第42期は回復基調)
- 半導体製造装置向けマテリアル製品、産業機器・車載向けパワー半導体基板などは伸長の見通し
- 医療・バイオ、およびウェアラブル分野におけるサーモモジュール、磁性流体は安定した需要の見通し

セグメント別事業概況



当社は、製品用途の類似性と販売先業種により区分し「半導体等装置関連事業」「電子デバイス事業」の2事業を報告セグメントとしております。

半導体等装置関連事業
電子デバイス事業
その他

	第40期 (内周)	第41期 (外周)
半導体等装置関連事業	64.8%	66.4%
電子デバイス事業	16.5%	19.1%
その他	18.7%	14.5%

半導体等装置関連事業

エレクトロニクス産業は、半導体や有機ELパネルメーカーの設備投資が再開され、年央から回復基調が鮮明となりました。半導体のウエーハプロセスに使用される当社のマテリアル製品は、世界的なリモートワークやWEB会議システムの普及拡大に伴い、PCやサーバー用途の半導体需要が急増し、デバイスメーカー各社の設備稼働率が高水準となり、同製品の販売は前年を上回りました。半導体の需要は旺盛であり、一部業界では需給がひっ迫し、品不足も発生しております。

売上高 **606**億円 営業利益 **61**億円



セラミックス製品



真空シール

電子デバイス事業

主力のサーモジュールは、新型コロナウイルス感染症の影響により、北米市場および中国市場での自動車販売台数が前年割れとなり、自動車温調シート向けは軟調な展開となりましたが徐々に回復に転じました。5G用の移動通信システム機器用途は力強く伸長し、PCR等の医療検査装置向けも堅調に推移いたしました。他の産業用途では、家電製品を含む民生向けが好調を維持し、半導体向けが計画を上回りました。パワー半導体用基板は、DCB基板が順調に売上を伸ばしており、新製品のAMB基板も顧客認定が進み量産を開始しております。

売上高 **172**億円 営業利益 **44**億円



磁性流体



サーモジュール

※ 記載金額は、億円未満を切り捨てて表示しております。
各セグメントの売上高は、外部顧客に対する数値を記載しております。

連結財務諸表(要約)

決算情報についての最新情報、詳細につきましては当社のIRサイトをご覧ください。
<https://www.ferrotec.co.jp/ir/>



連結貸借対照表

(単位:百万円)

科目	当期 2021年3月31日現在	前期 2020年3月31日現在
資産の部		
流動資産	88,077	71,451
固定資産	89,112	118,558
有形固定資産	53,043	110,816
無形固定資産	1,814	500
投資その他の資産	34,254	7,241
資産合計	177,189	190,010
負債の部		
流動負債	58,890	61,443
固定負債	40,059	78,418
負債合計	98,949	139,862
純資産の部		
株主資本	63,408	46,942
その他の包括利益累計額	3,684	1,452
新株予約権	81	73
非支配株主持分	11,064	1,679
純資産合計	78,239	50,147
負債純資産合計	177,189	190,010

※ 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

科目	当期 2020年4月1日から 2021年3月31日まで	前期 2019年4月1日から 2020年3月31日まで
営業活動による キャッシュ・フロー	13,217	8,902
投資活動による キャッシュ・フロー	△20,879	△34,472
財務活動による キャッシュ・フロー	21,694	17,996
現金及び現金同等物に係る 換算差額	174	△395
現金及び現金同等物の 増減額(△は減少)	14,207	△7,968
現金及び現金同等物の 期首残高	23,709	31,555
連結の範囲の変更に伴う現金及び 現金同等物の増減額(△は減少)	△7,714	122
現金及び現金同等物の 期末残高	30,202	23,709

※ 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

連結損益計算書

(単位:百万円)

科目	当期 2020年4月1日から 2021年3月31日まで	前期 2019年4月1日から 2020年3月31日まで
売上高	91,312	81,613
売上原価	60,530	54,685
売上総利益	30,782	26,928
販売費及び一般管理費	21,141	20,915
営業利益	9,640	6,012
営業外収益	1,609	1,612
営業外費用	3,022	3,361
経常利益	8,227	4,263
特別利益	5,544	523
特別損失	2,483	1,246
税金等調整前当期純利益	11,288	3,540
法人税等	3,339	1,897
当期純利益	7,948	1,642
非支配株主に帰属する当期純利益又は 非支配株主に帰属する当期純損失(△)	△332	△142
親会社株主に帰属する当期純利益	8,280	1,784

※ 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

連結包括利益計算書

(単位:百万円)

科目	当期 2020年4月1日から 2021年3月31日まで	前期 2019年4月1日から 2020年3月31日まで
当期純利益	7,948	1,642
その他の包括利益	2,358	△2,283
その他有価証券評価差額金	272	△76
為替換算調整勘定	1,595	△2,169
退職給付に係る調整額	43	△5
持分法適用会社に対する持分相当額	448	△32
包括利益	10,307	△640
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	10,513	△467
非支配株主に係る包括利益	△205	△172

※ 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

株式情報 / 会社情報 (2021年3月31日現在)

株式の状況

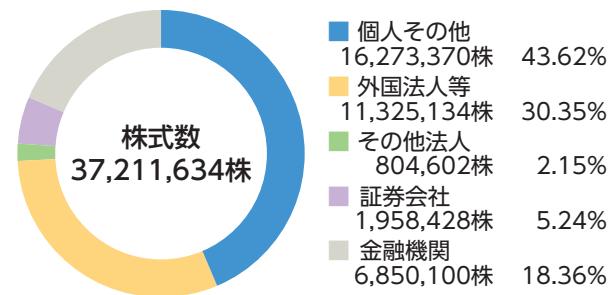
発行可能株式総数	67,000,000株
発行済株式総数	37,305,202株
株主数	22,343名

大株主

株主名	持株数(株)	持株比率(%)
株式会社日本カストディ銀行(信託口)	2,039,400	5.46
JP MORGAN CHASE BANK 385632	1,388,111	3.72
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC)	909,232	2.43
山村 章	843,200	2.26
MSCO CUSTOMER SECURITIES	782,600	2.09
NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB)	775,400	2.07
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	754,900	2.02
上田ハ木短資株式会社	690,000	1.84
UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT	592,740	1.58
日本証券金融株式会社	482,200	1.29

(注) 1. 当社は、自己株式93,568株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2. 表示単位未満を切り捨てて表示しております。

所有者別株式分布状況



(注) 1. 自己株式93,568株は上記の円グラフ中の株式数に含まれておりません。
2. 表示単位未満を切り捨てて表示しております。

会社概要

商号	株式会社フェローテックホールディングス (英文表記) Ferrotec Holdings Corporation
設立	1980年9月27日
資本金	177億265万702円
株式公開	株式会社東京証券取引所 JASDAQ 1996年10月18日(証券コード: 6890)
決算期	3月31日
従業員数	7,380名(連結)

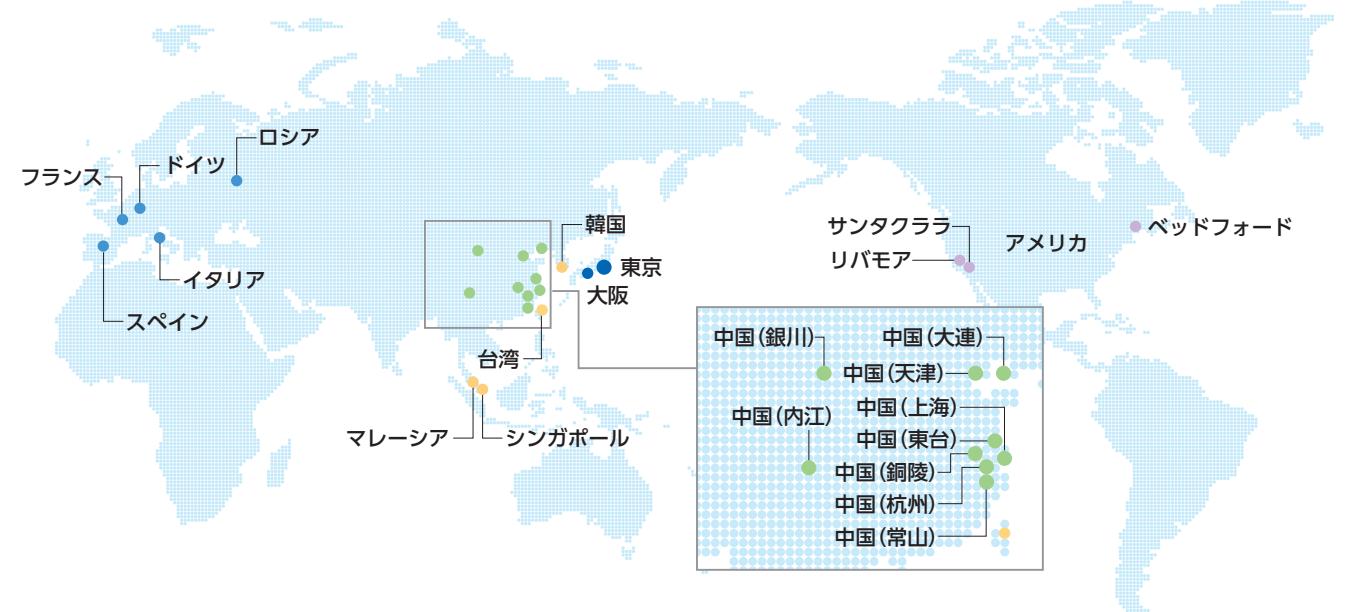
所在地

本社	〒103-0027 東京都中央区日本橋2-3-4 日本橋プラザビル5階
----	---

役員 (2021年6月29日現在)

取締役	
代表取締役会長	山村 章
代表取締役社長	賀 賢 漢
代表取締役副社長	山村 丈
取締役	若木 啓男
取締役	鈴木 孝則
取締役	宮永 英治
社外取締役	柳澤 邦昭
社外取締役	岡田 達雄
社外取締役	下岡 郁
監査役	
常勤社外監査役	樋口 隆昌
社外監査役	藤本 豪
監査役	吉田 勝

グローバルネットワーク



欧州

- フランクフルト (ドイツ)
- シュツットガルト (ドイツ)
- モスクワ (ロシア)
- リヨン (フランス)
- ミラノ (イタリア)
- マドリッド (スペイン)

中国

- 杭州
- 上海
- 銀川
- 天津
- 内江
- 大連
- 東台
- 銅陵
- 常山

東南アジア

- シンガポール
- 新竹 (台湾)
- ウィワソ (韓国)
- タンジン (韓国)
- クアラルンプール (マレーシア)

日本

- 東京 [本社]
- 千葉
- 兵庫
- 石川
- 大阪
- 岡山
- 神奈川
- 山形
- ベッドフォード
- リバモア
- サンタクララ

販売拠点 生産拠点